



kingston.com/epop

ePoP

ePoP – Embedded Package-on-Package пам'ять (вбудована пам'ять с упаковкою «корпус на корпусі») для пристроїв, що носяться

ePoP-рішення від Kingston — це високоінтегровані стандартні JEDEC компоненти, які поєднують в одному корпусі eMMC (Embedded MultiMedia Card) сховище та оперативну пам'ять LPDDR DRAM, встановлені один над одним (PoP). Компонент ePoP встановлюється безпосередньо нагорі сумісної системи-на-кристалі (SoC), що дозволяє економити місце на друкованій платі та забезпечує оптимальну продуктивність. Пам'ять ePoP є ідеальним рішенням для таких компактних пристроїв, як натільні пристрої, що носяться.

ОСОБЛИВОСТІ

- Пам'ять ePoP встановлюється безпосередньо на SoC і є ідеальним вибором для таких рішень з малим форм-фактором, як пристрої, що носяться.
- Спрощує розробку систем, зменшує час на виведення на ринок та скорочує цикл сертифікації.
- DRAM-пам'ять з низьким енергоспоживанням та оптимізована прошивка сховища дозволяють знизити енерговитрати із одночасним підвищенням продуктивності, що є дуже важливим у разі використання акумуляторних пристроїв, що носяться.
- Доступні різні варіації прошивки, які дозволяють підібрати оптимальний варіант щодо продуктивності, енергоспоживання та ресурсу.

СЕГМЕНТИ РИНКУ



Інтернет речей (IoT)



Пристрої, що носяться



Пристрої доповненої реальності та віртуальної реальності

АРТИКУЛИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ePoP на базі LPDDR3

Part Number	Ємність		Стандартна		Корпус	FBGA	Робоча температура
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10 x 10 x 0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C

ePoP на базі LPDDR4x

Part Number	Ємність		Корпус		Корпус	FBGA	Робоча температура
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,85	144	-25°C ~ +85°C

*режим pSLC задля більшого ресурсу

